

2018-2019学年第一学期班级课表

 班级：1514021
 微电子学院

节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
上	1-2节 功率集成电路 (MI5122-01) B-537 张骥(讲师) 第1-18周(1-2节)	集成电路新技术讲 座(MI3017-01) C-323 马晓华(教授)张进成 (教授) 第1-3,6-10周(1-2节)	微电子封装技术 (MI5121-01) B-537 包军林(副教授) 第1-10周(1-2节)	微电子封装技术 (MI5121-01) B-537 包军林(副教授) 第1-9周(1-2节)	集成电路可靠性 (MI3007-02) B-537 刘红侠(教授)刘莉(副 教授) 第1-9周(1-2节)	
	3-4节 专用集成电路设计 (研讨课)(MI3011- 01) B-537 张骥(讲师) 第1-18周(3-4节)		集成电路可靠性 (MI3007-02) B-537 刘红侠(教授)刘莉(副 教授) 第1-10周(3-4节)	嵌入式系统设计 (MI3020-01) C-323 李康(副教授) 第1-13周(3-4节)		
下	5-6节 专业教育(IV) (MI1009-4-02) B-537 蔡觉平(教授) 第3-4周(5-6节)	集成电路测试技术 (MI3016-01) B-537 张弘(副教授) 第1-10周(5-6节)	半导体传感器与 MEMS技术(MI3019- 01) B-605 娄利飞(副教授) 第1-10周(5-6节)	集成电路测试技术 (MI3016-01) B-537 张弘(副教授) 第1-9周(5-6节)		
	形势与政策(VII) (HA1008-714-04) B-537 张波(工程师) 第6-7周(5-6节)					
午	7-8节 半导体光电子器件 (MI3009-02) C-323 胡辉勇(教授) 第1-10周(7-8节)	半导体传感器与 MEMS技术(MI3019- 01) B-605 娄利飞(副教授) 第1-10周(7-8节)		有机半导体材料与 器件(MI3023-01) B-537 常晶晶(教授)林珍华 (副教授) 第1-17周(7-8节)	半导体光电子器件 (MI3009-02) B-606 胡辉勇(教授) 第1-9周(7-8节)	
晚上	9-10节					
其它:	MI4004-02	集成电路设计实践	第1-18周	学院组织实施	史江义(副教授)	
	MI4003-01	集成电路制造生产实 习	第1-18周	学院组织实施	李跃进(教授)丁瑞雪 (副教授)李娅妮(副教 授)	
课程名称		学时	学分	课程属性	考核方式	说明
集成电路设计实践		4+44+6+6+2周	2	必修	考查	合班
集成电路制造生产实习		30+2+15+2周	2	必修	考查	合班
形势与政策(VII)		4	0.2	必修	考查	
专业教育(IV)		4	0.2	必修	考查	合班
半导体传感器与MEMS技术		28+4	2	学院选修	考查	合班
半导体光电子器件		32	2	学院选修	考查	合班
功率集成电路		28+4	2	学院选修	考查	合班
集成电路测试技术		28+4	2	学院选修	考查	合班
集成电路可靠性		28+4	2	学院选修	考查	合班
集成电路新技术讲座		14+2	1	学院选修	考查	合班
嵌入式系统设计		24+16	2	学院选修	考查	合班
微电子封装技术		30+2	2	学院选修	考查	合班
有机半导体材料与器件		32	2	学院选修	考查	合班
专用集成电路设计(研讨课)		24+16	2	学院选修	考查	合班